（上接B077版）

（3）2025 年度资本开支前十大流入方

序号	流入方名称	交易金额（万元）	主要投向	对应形成的资产科目	用途	建成时间
1	广东电白建设集团有限公司	17,861.18	新一代项目房屋建设	固定资产	生产车间	2025年7月
2	中铁二十四局集团厦门建设发展有限公司	15,803.64	新一代项目房屋建设	在建工程	二期项目建设	未完工
3	苏州维嘉科技股份有限公司	12,279.72	新一代项目设备采购	固定资产	PCB生产设备	2025年12月
		417.70	高密度板项目设备采购	在建工程	PCB生产设备	未完工
	小计	12,697.42	/		/	/
4	上海天承化学有限公司	10,573.45	新一代项目设备采购	在建工程	PCB生产设备	未完工
5	广东佐欧建筑工程有限公司	6,020.65	新一代项目房屋建设	固定资产	生产车间、文体中心	2025年7月/9月
		1,031.00	江苏博敏1A期技改项目房屋建设	固定资产	生产车间	2025年9月
	小计	7,051.65	/		/	/
6	中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司	5,009.97	新一代项目房屋建设	固定资产	办公楼	2025年10月
7	江西宸鸿智能装备有限公司	4,069.03	新一代项目设备采购	在建工程	PCB生产设备	未完工
8	东莞宇宙电路板设备有限公司	3,400.88	新一代项目设备采购	在建工程	PCB生产设备	未完工
9	保德科技有限公司	3,324.01	新一代项目设备采购	在建工程	PCB生产设备	未完工
10	深圳市申铂锐科技有限公司	3,271.24	新一代项目设备采购	在建工程	PCB生产设备	未完工
合计		83,062.47				

2、项目达产情况及产能利用率情况

2023-2025年公司购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金合计31.51亿元，分项目具体构成如下：

项目	投入金额（万元）	占比（%）	主要对应项目
房屋及建筑物	182,055.78	57.77	新一代项目
机器设备	52,197.61	16.56	新一代项目
机器设备	32,693.04	10.37	高密度板项目(含IC载板)
机器设备	27,725.52	8.80	各基地技改
房屋及建筑物	16,357.85	5.19	高密度板项目
其他	4,103.16	1.30	办公及运输设备之类
合计	315,132.96	100.00	

公司固定资产投资主要集中于梅州和江苏两大核心产能扩建项目，其中：新一代电子信息产业投资扩建项目（梅州）房屋及建筑物项目在2023-2025年累计投入18.20亿元，截至2025年末对应的房屋及建筑物账面金额达13.67亿元，是新增固定资产中金额最大的单项；主要原因系新一代项目为全新征地建设的产业园，占地282.7亩，规划总建筑面积42万平方米，需从零规划并完成土地平整、厂房土建、公用工程（配电、废水废气处理、制冷供热）、研发办公与生活配套等全套基础设施建设，土建及配套投资占总投资比重较高，抬升了整体资本开支规模。

截至2025年末，新增主要项目达产情况及产能利用率情况如下：

序号	项目名称	建成时间	2025年达产状态	2025 年实际产量	2025 年产能利用率
1	新一代项目设备采购（钻孔车间设备）	2025年12月	/	/	/
2	新一代项目设备采购（其他设备）	未完工	/	/	/
3	高密度板项目数字化建设项目	2025年4月	/	/	/
4	高密度板项目设备采购	2023年5月开始持续进行	稳产	20.94万㎡	82%

（二）结合产能消化情况及在手订单变化，说明相关资本开支持续较大的商业合理性，是否存在通过在建工程核算滞留应费用化支出等调节各期损益的情形，相关资金是否存在直接或间接流向控股股东及其关联方的情形

1、23-25年产能利用率情况，各期末在手订单情况

2023-2025年公司购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金合计 31.51亿元，主要用于新一代电子信息产业投资扩建项目和高密度多层刚挠结合印制电路板产业化项目建设。相关资本开支持续较大的商业合理性如下：

（1）资本开支紧扣行业趋势与公司战略，具备必要性

当前 AI 算力、汽车电子等高端领域快速发展，对高多层板、高阶HDI、刚挠结合板等高端PCB产品的技术标准与产能需求持续提升；公司原有的中低端通用产品产能较多，无法充分覆盖高端市场需求。2020年以来持续的大额资本开支围绕公司“PCB +元器件+解决方案”上下游一体化发展战略，通过两大生产基地建设项目补齐高端产能短板，切入高附加值赛道，是公司把握行业机遇、优化产品结构、强化核心竞争力的必要投入。

（2）项目产能消化及未来预期情况良好

高密度多层刚挠结合印制电路板产业化项目：项目总规划年产能12万平方米高精密多层刚挠结合板，产品聚焦车载、工控医疗、高端消费电子等高端应用场景。项目于2023 年3月正式投产并进入产能爬坡期，2023-2025 年产能利用率持续稳步提升，截至2025年末整体产能利用率约82%，逐步接近满产状态，未来市场预期良好。截至2025年末，该项目在手订单金额10,660万元，订单储备充足，可有效覆盖现有产能产出；同时产品已批量供应下游高景气度行业的头部客户，需求具备持续性，直接验证了项目前期投建的市场价值与必要性。

新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）：一期总规划年产能172万平方米高端PCB，涵盖高多层板、高阶HDI、高频高速板等品类，截至2025年末，该项目尚未正式投产，因此暂未形成批量在手订单，但公司整体在手订单2025 年末同比增长41.37%，高端品类订单增速显著高于整体的趋势，叠加预期 AI 服务器、汽车电子领域客户有望持续导入，后续产能逐步释放具备充足的市场需求支撑。

（3）同行业可比公司资本开支情况

2023-2025年鹏鼎控股、胜宏科技、方正科技等同行业可比公司也持续加大资本开支，用于建设高端PCB产能，公司资本开支规模与部分同行业可比公司相比处于合理水平，具体情况如下：

序号	可比上市公司	近三年的项目建设及资本开支情况
1	鹏鼎控股	根据该公司公告，2025 ,2026年先后在淮安启动总投资为80亿元 ,110亿元高端PCB扩建项目，产品方向包括高阶SLP/HDI、AI服务器/光模块PCB、车载PCB、IC载板，匹配AI算力、消费电子 ,汽车电子赛道等
2	方正科技	2025年启动通过再融资建设人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，募集资金总额19.80亿元
3	超颖电子	2025年启动超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段建设，募集资金总额8.97亿元
5	红板科技	2026年通过首发上市融资建设超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段，募集资金总额17.70亿元
6	骏亚科技	近三年完成年产80万平方米智能互联高精密线路板项目，募集资金总额约5亿元
7	中京电子	2026年通过再融资募资约8亿元，用于泰国PCB智能化基地（海外高多层、车载PCB产能，配套东南亚客户），惠州产线技改升级（高阶HDI、算力板产线智能化改造）
8	科翔股份	近几年通过两次简易程序融资建设江西科翔MiniLED用PCB产线建设项目、智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目，募集资金总额约5亿元
9	胜宏科技	近两年通过再融资+港股上市累计募资超过200亿元用于越南胜宏人工智能HDI项目、泰国高多层印制线路板项目
10	世运电路	2024年通过再融资募资约18亿元用于鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目（二期）以及广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目

注：因各上市公司自有资金进行的资本投入或项目建设未披露或披露不完整，以上仅统计部分同行业公司中通过再融资或公告方式进行的资本投入且与公司项目类似产品的项目建设。

当前行业整体处于高端产能扩张的高景气周期，公司加大固定资产投资，是顺应行业发展趋势、抢占高端市场的正常扩张行为。公司资本开支规模高于可比公司骏亚科技和世运电路，主要是因为公司梅州和江苏两大生产基地建设项目的核心建设周期恰好覆盖2023-2025年，是项目量级、建设周期、技术定位与投入模式共同形成的合理差异。

2、是否存在通过在建工程核算滞留应费用化支出等调节各期损益的情形，相关资金是否存在直接或间接流向控股股东及其关联方的情形

公司2023-2025年资本开支资金主要用于支付工程建设款和设备采购款，收款方均为独立的第三方企业，与公司控股股东及其关联方不存在关联关系。公司建立了严格的资金管理制度，明确了资金支付的审批程序和权限，所有资本开支资金支付均经过严格的审批，确保资金使用的合规性和安全性。

二、结合固定资产的主要构成、对应项目的投产进度及产能利用率、预期收益率与实际运营数据等，评估各项固定资产是否存在减值迹象，是否存在效益不及预期、应计提减值而未计提的情形；对比同行业可比公司减值计提比例及行业周期趋势，说明公司固定资产减值计提政策与行业是否存在显著差异；

（一）2025年末固定资产的主要构成、对应项目的投产进度及产能利用率、预期收益率与实际运营数据等

公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，且使用寿命超过一个会计年度的有形资产，在同时满足“经济利益很可能流入企业、成本能够可靠计量”两项条件时予以确认。

2025年末，公司固定资产账面价值合计413,003.46万元，较期初增长 51.83%，主要系新一代电子信息产业投资扩建项目部分资产达到预定可使用状态转入固定资产所致。按资产类别与对应投资项目拆分明细如下：

单位：元

序号	固定资产	对应项目名称	期末原值	项目投产进度	项目产能利用率
1	房屋及建筑物	新一代电子信息产业投资扩建项目（梅州）	1,367,796,984.72	/	/
2	机器设备		138,036,347.80	测试	测试
5	办公及其他设备		5,015,049.77	正常使用	/
6	房屋及建筑物	高密度多层刚挠结合印制电路板产业化项目（江苏）	545,603,979.21	/	/
7	机器设备		689,138,962.31	已投产	82%
8	机器设备	江苏博敏IC载板	86,728,470.54	已投产	
9	机器设备	深圳博敏5G无线通信系统多通道天线基板技改	158,434,974.85	已投产	77%
10	机器设备	江苏博敏1A期技改项目	175,504,385.94	已投产	92%

注：江苏博敏IC载板为高密度项目（高阶HDI）配套核心工序，其产能利用率与该项目同步。

公司依据《企业会计准则第8号 一一 资产减值》相关规定，在资产负债表日对各项固定资产及对应资产组进行减值迹象排查，判断标准包括：资产市价大幅下跌、经营环境发生重大不利变化、市场利率显著提升、资产陈旧过时或实体损坏、资产闲置或计划提前处置、经济绩效低于预期等。结合各项目实际运营情况，逐项评估如下：

（1）新一代项目（已转固部分）：

目前处于试生产初期阶段，尚未正式投产，随着产能逐步释放和产品结构优化，预计未来收益率将逐步提升至预期水平。截至2025年末，该资产组的可收回金额高于账面价值，不存在减值迹象。

（2）高密度板项目：

高密度板项目分两期规划建设，其中一期工程聚焦消费电子、汽车电子领域刚挠结合板产品，项目于2023年3月正式投产并进入产能爬坡期，2023-2025年产能利用率持续稳步提升，截至2025年末整体产能利用率约82%，逐步接近满产状态，未来市场预期良好。

经营效益方面，一期项目投产以来的经济效益如下：

年度	营业收入（万元）	毛利金额（万元）
2023年	5,273.80	-4,341.55
2024年	23,740.07	-7,172.53
2025年	37,213.30	2,062.27

如上表，一期项目自投产以来收入金额持续增加，2025年度实现毛利 2,062.27万元，首次实现毛利金额转正，已形成稳定的收入与利润贡献。但是，受消费电子行业需求阶段性波动、汽车电子领域客户认证周期长于预期、行业短期竞争加剧等外部因素影响，非资产盈利能力永久恶化；第三，订单与长期需求具备支撑，可收回金额高于账面价值，截至2025年末，项目在手订单规模1.07亿元，客户储备持续丰富，下游汽车电子、可穿戴设备等高端应用领域长期成长逻辑未发生改变。结合当前盈利水平与未来经营预期，该资产组预计未来现金流量现值高于其账面价值，可收回金额不存在低于账面价值的情形，不满足计提减值准备的条件。

综上所述，高密度板项目当前经济效益低于前期可研预期，但项目收入和利润持续增加；公司期末各项固定资产均不存在减值迹象，不存在应计提减值而未计提的情形。

（二）对比同行业可比公司减值计提比例及行业周期趋势，说明公司固定资产减值计提政策与行业是否存在显著差异；

公司固定资产减值计提政策严格遵循《企业会计准则第8号 一一 资产减值》规定：资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象，存在减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额低于账面价值的，按差额计提减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。该政策与同行业可比公司完全一致，不存在显著差异。

2025年PCB行业整体处于复苏周期，A1算力、汽车电子等高端领域需求快速增长，行业整体产能利用率提升，全行业固定资产减值计提比例普遍处于较低水平。公2025年度未计提固定资产减值，核心原因系公司核心产能对应的下游需求向好，资产运营效益持续改善，不存在减值迹象。同时，2025年度，公司主动对存量低效及不符合新产品工艺要求的固定资产进行清理，当期处置或报废固定资产原值10,238.34万元，对应累计折旧7,909.22万元，处置报废净损失2,329.12万元，占期初固定资产原值比例为0.53%，高于行业平均水平。

同行业上市公司对比情况如下：

序号	同行上市公司	处置或报废比例（%）
1	万正科技	0.16
2	超颖电子	未披露
3	红板科技	未披露
4	协和电子	0.12
5	迅捷兴	0.75
6	中京电子	0.17
7	鹏鼎控股	-3.22
8	强达电路	0.55
9	胜宏科技	0.80
10	明阳电路	0.20
11	骏亚科技	0.91
12	科翔股份	1.64
行业平均		0.21
博敏电子		0.53

综上，公司固定资产减值计提政策与企业会计准则及同行业可比公司保持一致，不存在显著差异；2025年未计提固定资产减值符合行业周期趋势与公司实际经营情况，具备合理性。

三、按工程项目、功能类别等明细列示新一代项目期末余额的具体构成、投入进度、转固条件、实际使用状态，区分已投产与未投产部分；逐一判断各明细项目是否存在应转固未转固、推迟转固的情形，是否符合企业会计准则的相关规定；

（一）按工程项目、功能类别等明细列示新一代项目期末余额的具体构成、投入进度、转固条件、实际使用状态，区分已投产与未投产部分

新一代电子信息产业投资扩建项目投资总额 30亿元，截至 2025年末，工程累计投入26亿元，转入固定资产15亿元，在建工程11亿元。具体构成如下：

工程项目	功能类别	期末余额（万元）	投入进度	转固条件	实际使用状态	是否投产
房屋主体工程	一期生产车间	0.00	100.00%	达到预定可使用状态	已投入使用	已投产
房屋主体工程	办公楼	0.00	100.00%	达到预定可使用状态	已投入使用	已投产
房屋主体工程	宿舍及配套	0.00	100.00%	达到预定可使用状态	已投入使用	已投产
设备安装工程	生产设备	56,651.96	86.72%	安装调试完成并通过验收	部分投入使用	部分投产
设备安装工程	辅助设备	1,840.82		安装调试完成并通过验收	部分投入使用	部分投产
公用工程	电力设施、给排水设施、环保设施	0.00	100.00%	达到预定可使用状态	已投入使用	已投产
二期项目建设	生产车间工程建设	50,569.00	86.72%	达到预定可使用状态	未投入使用	未投产

（二）逐一判断各明细项目是否存在应转固未转固、推迟转固的情形，是否符合企业会计准则的相关规定；

根据《企业会计准则第4号 一一 固定资产》的规定，自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。资产达到预定可使用状态，是指资产已经达到购买方或建造方预定的可使用状态。

公司对新一代项目各明细项目进行了逐一核查，判断结果如下：

1、房屋主体工程：生产车间、办公楼、宿舍及配套设施分别于2025年4 月、7月、9月、10月陆续达到预定可使用状态，公司均于达到状态当月转入固定资产，不存在应转固未转固、推迟转固的情形。

2、设备安装工程-生产设备：截至2025年末，该项目尚未完全完工，部分设备已投入使用，公司已将投入使用部分转入固定资产，未完工部分仍作为在建工程核算，不存在应转固未转固、推迟转固的情形。其中：（1）未转固对应资产主要为机器设备及辅助设备，未转固原因为暂未调试合格；（2）已使用部分对应产线为钻孔车间的钻机等，转固条件为经工艺部、设备部对设备性能、生产和品质进行测试验证合格，均达到可使用状态后转固；（3）后续建设及转固计划：因新一代一期项目定位生产服务器、交换机、数据中心等高速高多层产品的工厂，此类产品在对准度、信号完整度、阻抗三值管控、背钻、POFV等特殊工艺的要求较高；为实现未来产品高品质交付，2026年需先实现全制程生产工序的拉通，其次着手进行产品的逐步试产，过程中需逐步对设备及产线进行能力检测、设备稳定性、故障率等评估，因此，未经过大批量产品验证及极限能力确认的设备暂不符合转固条件；预计2026年将稳步有序推进设备转固进程。

3、设备安装工程-辅助设备：截至2025年末，该项目尚未完全完工，部分设备已投入使用，公司已将已投入使用部分转入固定资产，未完工部分仍在在建工程核算，不存在应转固未转固、推迟转固的情形。

4、公用工程-电力设施、给排水设施、环保设施：截至2025年末，该项目已完工投入使用，公司已将已投入使用部分转入固定资产，不存在应转固未转固、推迟转固的情形。

5、二期项目建设：截至2025年末，二期厂房处于主体施工阶段，尚未完成竣工验收，未达到预定可使用状态，继续在建工程核算，不存在应转固未转固、推迟转固的情形。未来，二期项目将按计划稳步推进建设，后续工程计划为优先完成土建工程的竣工验收，后续开展设备投入及相关的生产规划。

综上所述，新一代项目各明细项目均按照企业会计准则的规定及时转固，不存在应转固未转固、推迟转固的情形。

四、补充披露2024年至2025年新一代项目利息资本化所对应的借款构成、资金具体投向、资本化期间，结合项目陆续投产、转固的实际情况，说明相关利息资本化是否符合企业会计准则的规定，是否存在少计财务费用的情形；

（一）补充披露2024年至2025年新一代项目利息资本化所对应的借款构成、资金具体投向、资本化期间，结合项目陆续投产、转固的实际情况

2024-2025 年，公司新一代项目利息资本化所对应的借款构成如下：

借款类型	2024 年金额（万元）	2025 年金额（万元）	利率区间
长期借款	47,756.55	48,407.62	2.70%-3.40%
短期借款	/	/	/

其中，上述长期借款利息资本化的具体情况如下：

资金投向	投入金额（元）			开始建设时间	资本化期间	转固及停止资本化时间
	2024年	2025年	合计			
房屋主体工程（A/B座宿舍）	57,936,470.06		57,936,470.06	2023年1月	2024年2月-2025年3月	2025年4月
房屋主体工程（6,7#楼）	61,323,997.08	80,727,097.53	142,051,094.61	2023年8月	2024年2月-2025年6月	2025年7月
房屋主体工程（1#楼）	35,266,680.57	17,409,520.57	52,676,201.14	2024年1月	2024年1月-2025年8月	2025年9月
房屋主体工程（3#楼）	85,785,685.06	178,899,606.14	264,685,291.20	2023年5月	2024年2月-2025年6月	2025年7月
房屋主体工程（2#楼）	156,565,090.50	49,215,249.40	205,780,339.90	2023年10月	2024年1月-2025年9月	2025年10月
设备采购及安装（钻孔车间设备）		32,014,270.00	32,014,270.00	/	2025年12月-2025年11月	2025年12月
设备采购及安装（其他车间设备）	72,352,588.15	100,781,001.42	173,133,589.57	/	2024年8月-2025年12月	未转固
公用工程及配套设施（废气塔工程）	8,335,000.00	10,377,000.00	18,712,000.00	2024年11月	2024年12月-2025年12月	未转固
公用工程及配套设施（中央加药工程）		14,652,401.72	14,652,401.72	2025年1月	2025年3月-2025年12月	未转固
合计	477,565,511.42	484,076,146.78	961,641,658.20	-	-	-

综上，新一代项目借款资金全部用于项目的工程建设和设备采购，具体投向为房屋主体工程占比约75.2%，设备采购及安装占比约21.3%，公用工程及配套设施占比约3.5%。新一代项目于2021年12月开始动工，部分资产分别在2025年 4月、7月、9月、10月、12月陆续达到预定可使用状态。根据《企业会计准则第 17号一一借款费用》的规定，未达到预定可使用状态的资产发生的借款费用资本化期间为2024年1月至2025年12月，对于已达到预定可使用状态的资产在以后发生的借款费用，公司已将其计入当期损益。

（二）相关利息资本化是否符合企业会计准则规定，是否存在少计财务费用的情形

公司严格按照《企业会计准则第17号一一借款费用》的规定进行利息资本化核算：借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

新一代项目在2021年11月同时满足上述三个条件，公司开始将借款费用资本化。部分资产分别在2025年4月、7月、9月、10月、12月达到预定可使用状态，公司停止该部分资产对应的借款费用资本化。2025年新一代项目利息资本化金额2,926万元，累计资本化金额7,071万元，均符合《企业会计准则》的规定。

综上，公司不存在少计财务费用的情形。审计机构对公司2025年度利息资本化情况进行了审计，认为公司利息资本化核算符合企业会计准则的规定。

五、分析说明2024年至2025年高密度板项目投入进度减缓、仍处于爬坡状态的原因及合理性，项目可行性是否发生重大变化；结合近两年对该项目减值迹象的判断依据、减值测试的主要参数、过程，分析说明相关资产是否存在减值迹象，是否存在应计提未计提减值准备的情形。

（一）说明2024年至2025年高密度板项目投入进度减缓、仍处于爬坡状态的原因及合理性，项目可行性是否发生重大变化

高密度板项目总投资20亿元，分两期建设：一期总投资5.88亿元（含 2020 年再融资募资4.38亿元）已全额投入，2023 年 3 月正式投产，2025年实现营业收入3.72亿元，产能稳步爬坡，整体运营符合预期。截至2025年末，高密度板项目累计总投入12.9亿元，整体进度64.48%，较2023年末提升 9.48个百分点；其中二期总投资14.12亿元，累计投入7.02亿元，投入节奏较原计划有所放缓，主要原因如下：

1、项目投入进度放缓、处于爬坡阶段的原因及合理性

（1）应用场景拓展拉长技术调整和客户导入周期：伴随AI算力、光通信等高端需求快速扩容，公司在保持高阶HDI核心产品定位不变的基础上，将二期应用场景从原IoT、智能终端等领域延伸至AI服务器、光模块等高附加值赛道，相应优化产线技术配置与设备选型，延长了方案论证和客户导入周期。

（2）高端产线调试周期更长：二期定位高精度高阶HDI产线，设备交付排期、工艺调试、环保验收等标准显著高于常规产线，目前已进场的部分设备仍处于调试阶段，客观上拉长了整体建设周期。

（3）自有资金约束放缓投入节奏：二期原计划以自有及自筹资金于2025年建成，受资金储备及行业周期变化影响，实际投入节奏有所延后。

2、项目可行性未发生重大不利变化

（1）一期运营已验证项目商业逻辑：一期项目量产以来经营持续改善，2025年实现毛利2,062.27万元，已形成稳定的收入与利润贡献，核心技术路线、客户拓展模式均跑通，项目商业可行性已得到验证。

（2）客户储备充足，订单具备落地保障：公司400G、800G高阶HDI数连产品已实现批量交货，并与武汉光迅、海光芯创等光通信头部客户达成合作，二期投产后市场需求具备明确支撑。

（3）江苏基地运营能力为二期提供坚实支撑：江苏博敏作为公司高端产能运营主体，2025年实现扭亏为盈，毛利同比改善约234%；截至2026年6月末在手订单1.79亿元，且主要为高阶HDI产品，高端需求饱满。其积累的技术工艺、客户资源与生产管理经验可直接复用至二期，能够有效缩短产能爬坡周期、降低运营风险。

综上，目前二期工程已具备快速推进建设的各项条件，公司2026年度拟通过自有资金、银行贷款及资本市场融资等方式尽快推进及完成高密度二期工程建设、投产，以满足下游客户的相关需求。因此，公司在当前的环境下继续开展高密度项目具有合理性，项目可行性未发生重大变化。

（二）结合近两年对该项目减值迹象的判断依据、减值测试的主要参数、过程，分析说明相关资产是否存在减值迹象，是否存在应计提未计提减值准备的情形

公司根据企业会计准则资产减值相关要求结合公司实际情况，对高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目的减值迹象进行了逐项认定。如下：

序号	《企业会计准则第8号-资产减值》判断依据	判断过程	判断结论是/否/无
1	资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。	高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目总投资20亿元，包含厂房土建、专用PCB洁净车间、高端 FPC / 刚挠结合板生产设备、环保电镀配套设施；该项目于2020年底开工，2022年8月分批投产转固，2023年3月正式投产，定位A1、汽车电子、5G高端刚挠结合板产能；本项目持有目的为长期生产经营，核心价值来源于刚挠结合板产品盈利，厂房正常时间损耗仅体现为房屋建筑物折旧，项目核心设备、洁净装修、环评资质不存在随时间大幅贬值的情况。该项目2025 年实现营业收入3.72亿元，较上期增长56.75%，故该资产仅存在房屋建筑物平稳折旧这一正常预期贬值，不存在当期大幅、超预期市价下跌的客观证据。	否
2	企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。	2025年国内新能源汽车、AI 算力产业持续扩张，下游客户资本开支持续增加，行业需求长期向上，项目所在地产业集聚度持续提升，不存在区域经济衰退、产业空心化的重大变化，PCB行业整体未受国家政策压制。项目投入的设备新技术路线、现有产线快速贬值报废的重大技术利空。故不存在企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响的情形。	否
3	市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。	该项目产品面向 AI 算力、车载电子高景气赛道，2022-2025 年产能持续爬坡，产能利用率逐年提升，高阶刚挠板产品毛利率稳定、长期订单充足，未来预计现金流入规模持续增长。另外，基准利率 MLP 持续下调，2021年1年期 MLP 利率 2.95%，2022 年下调至 2.85%，2024 年进一步下调至 2.55%，2025 年全年维持低位，五年间无任何加息操作中长期市场利率整体平稳下行，中长期贷款定价基准5年期以上 LPR 自2021年4.65%持续下行至 2025 年末 3.50%，中长期信贷定价中枢持续走低，企业加权平均资本成本显著上行，折现率无大幅抬升，未出现可收回金额大幅下降。	否
4	有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。	高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目于2020 年末开工，2022年8月分批投产转固，2023年3月正式投产，至2025年末实际使用时长仅3-4年，2023 年转固二期车间、电镀成套设备；至2025年末实际使用时长仅2-3年，根据 PCB 专用设备行业惯用折旧年限10-15年（公司采用10年），项目设备资产实际使用年限仅占设计可使用年限的30%以内，房屋建筑物20-40年（公司采用20-40年），项目设备资产实际使用年限仅占设计可使用年限的10%以内，资产整体处于全新投产初期阶段，未进入自然老化、性能衰减周期，不具备“陈旧过时”的时间基础。	否
5	资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。	公司长期经营规划持续将高端刚挠结合板作为核心扩张赛道，规划持续稳定释放产能、拓展车载、AI 算力客户，产能利用率逐年提升，截至2025年12月末在手订单1.79亿元，且主要为高阶HDI产品，高端需求饱满，不存在厂房、产线长期闲置、停产的客观事实。	否
6	企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。	依据公司的《2025江苏博敏损益表预测表》内部中长期经营报告，2026至2030年江苏博敏营业收入分别为 160,000万元，180,000万元，193,000万元，210,000万元，215,000万元，对应利润总额分别为 6,980万元，7,574万元，9,387万元，10,684万元，13,401万元，营业收入与利润总额呈逐年稳步抬升趋势。高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目作为江苏博敏核心增量产能，是支撑未来收入、利润增长的核心载体，内部预测未出现项目未来收益大幅缩水、持续亏损，不存在“资产经济绩效将低于预期”的迹象。	否
7	其他表明资产可能已经发生减值的迹象。	未发现其他表明资产可能已经发生减值的迹象。	无

另外，根据《企业会计准则应用指南汇编2024》第九章第四点规定“企业应当根据实际情况来认定资产可能发生减值的迹象。有确凿证据表明资产存在减值迹象的，应当在资产负债表日进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产存在减值迹象是资产是否需要进行减值测试的必要前提，但是以下资产除外，即因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产”。

综合上述，高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目根据实际情况来认定资产可能发生减值的迹象。有确凿证据表明资产存在减值迹象的，应当在资产负债表日进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产存在减值迹象是资产是否需要进行减值测试的必要前提，但是以下资产除外，即因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产。

六、年审会计师核查程序及意见

基于已执行的核查程序，年审会计师认为：

1、公司已完整披露2023-2025年资本开支前十大流入方、资金主要投向、对应资产用途、项目建成及达产状态、实际产量与产能利用率；结合行业发展、市场需求及在手订单情况，公司持续大额资本开支具备商业合理性。公司在建工程、固定资产核算口径规范，严格区分资本性支出与费用性支出，不存在将应费用化支出滞留于在建工程调节损益的情形。根据已执行的审计程序，年审会计师未发现相关资金存在直接流向控股股东及其关联方的情况。

2、结合固定资产构成、项目投产进度、产能利用率及经营数据分析，公司各项固定资产运营状态正常，实际收益与预期不存在重大偏离，未发现明显减值迹象；公司固定资产减值计提会计政策、判断标准与同行业可比公司基本一致，结合当前PCB行业周期、资产使用状态，公司本期固定资产不存在应计提而未计提减值准备的情形，减值计提合规、充分。

3、公司已清晰列示新一代项目期末余额明细构成、各分项投入进度与实际使用状态；对于已达到预定可使用状态的工程及设备，公司均按规定及时办理转固手续，不存在应转固未转固、人为推迟转固的情形，项目转固判断标准、账务处理流程符合企业会计准则相关要求，会计核算规范。

4、新一代项目对应的借款构成、资金投向、资本化期间披露真实、准确。公司按照会计准则规定，在资产达到预定可使用状态后及时停止对应部分利息资本化，利息资本化范围、金额计算准确。不存在违规延长资本化期间、多计资本化利息、少计财务费用的情形，利息资本化核算合规。

5、高密度板项目进度放缓、处于产能爬坡系客观因素所致，房屋建筑物已一次性转固，生产设备受产线设备采购调试周期较长和公司资金储备以及行业周期变化等因素影响，分批落地、转固周期较长；项目产销逐年递增，2025年产销量较上年保持增长，一期项目已实现毛利2,062.27万元，后续随设备验收及订单增加将逐步达产；项目可行性未发生变化，无减值迹象。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司已完整披露2023-2025年资本开支前十大流入方、资金主要投向、对应资产用途、项目建成及达产状态、实际产量与产能利用率；结合行业发展、市场需求及在手订单情况，公司持续大额资本开支具备商业合理性；公司在建工程、固定资产核算口径规范，严格区分资本性支出与费用性支出，不存在通过在建工程核算滞留应费用化支出等调节各期损益的情形，未发现相关资金直接流向控股股东及其关联方的情形。

3.年报及前期公告数据显示，2025年末，公司全资子公司深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称君天恒讯）100%股权期末账面价值4.55亿元，本期未发生商誉减值。君天恒讯2025年实现营业收入4.18亿元，净利润7571万元，同比分别下滑8.7%、增长19.6%，实际收入表现低于2024年末预测。该公司2026年至2029年预测销售收入增长率分别为：-1.11%、10.01%、12.21%、11.20%，自2027年起恢复两位数增长；预测毛利率分别为21.21%、21.17%、22.38%、24.04%，高于2024年末的预测水平。

请公司补充披露：（1）君天恒讯2024年至2025年业务开展情况，包括业务模式、主要产品及应用领域、毛利率水平，主要供应商和客户名称及对应交易金额、应收应付款项及期后结转情况等，分析说明君天恒讯2025年营收下滑但净利润同比增长的原因及合理性，与同行业可比公司是否存在显著差异；（2）对比君天恒讯2024年末及2025年末商誉减值测试的关键参数假设、2025年实际业绩与预测值情况，详细说明存在差异的原因及合理性；结合君天恒讯所处细分行业发展情况、在手订单等，说明本期收入增长率、毛利率等关键参数的选取依据及合理性，未计提商誉减值准备是否审慎、准确。请年审会计师对问题（2）发表意见。

【回复】

一、君天恒讯2024年至2025年业务开展情况，包括业务模式、主要产品及应用领域、毛利率水平，主要供应商和客户名称及对应交易金额、应收应付款项及期后结转情况等，分析说明君天恒讯2025年营收下滑但净利润同比增长的原因及合理性，与同行业可比公司是否存在显著差异。

（一）君天恒讯2024年至2025年业务开展情况，包括业务模式、主要产品及应用领域、毛利率水平，主要供应商和客户名称及对应交易金额、应收应付款项及期后结转情况等

1、君天恒讯业务模式、主要客户情况、毛利率情况

君天恒讯是一家PCBA核心电子元器件综合化定制方案解决商，主要从事PCBA相关核心电子元器件的失效性分析、定制开发和销售，并提供相关品质监控、工艺指导、过程管理和危机处置等各个环节的技术支持和售后服务。自成立以来，君天恒讯专注于家电领域，向客户销售的产品均为电子元器件，已累计服务上百家智能控制和电源管理等领域客户，积累了大量电子元器件应用经验及失效性问题解决方案的成功案例。

近两年来，君天恒讯的主要客户为格力、美的、奥克斯等为代表的白电及智能